Specification No.

SA-1060S-A10-1/5

御中

# 製品 仕 様 書 Product specifications

製 品 名	1.0 ストレーン・リリーフターミナル
Product Name	1.0 Strain relief terminal
製品番号 Product Number	910461-2MA

受 領 FD 欄
Acknowledged

2					承 認	確認	作 成
1					Approved	Checked	Prepared
Rev.	2012.12.19	書式変更 Form change.	-	-			
Issue	1994. 6.13				草野	村	清
No.	日付	変更内容	変更	承認	野		ZK
INO.	Date	Revision	Change	Approved			

# 仕 様 書 Specifications

# 1. 適用範囲 (Scope)

この製品仕様書は「 1.0 ストレーン・リリーフターミナル」の一般仕様及び性能について 規定する。

The present document concerns general specifications and performances of " 1.0 Strain relief terminal ".

## 2. 製品名・製品番号 (Product name and number)

製品名	製品番号	材料及び表面処理
Product Name	Number	Material and surface treatment
1.0 ストレーン・ リリーフターミナル 1.0 Strain relief terminal	9 1 0 4 6 1 - 2 M A	黄銅 スズメッキ材 Brass, Pre-tin Plated

# 3. 形状・寸法・材料 (Geometry and materials)

添付図面による。

Refer to attached drawings.

図面番号	製品名	
Drawing No.	Product name	Mark
J C - 0 0 3 0 - 0 1 Z	1.0 ストレーン・リリーフターミナル 1.0 Strain relief terminal	0

## 4. 定格 (Rated values)

項目 Item	規格値 Description			
適用電線範囲(注1) Wire size (Note 1)	AWG#24~AWG#28 最大被覆外径 1.5mm AWG#24~AWG#28 Maximum diameter of insulation covering 1.5mm			
	厚さ Thickness	1.57±0.2mm		
適用プリント基板 Applicable P.C. board	穴径 Hole diameter	A W G # 2 4	A W G <sup>#</sup> 2 6 A W G <sup>#</sup> 2 8	
		1.1 +0.05 mm	1.0 +0.1 mm	

(注1) 電線はより線を使用し、単線等の特殊電線は原則として使用出来ません。

# 5. 性能 (Performances)

性能は、下表に示す試験条件及び方法で試験を実施したとき、各項目に規定する規格値を満足すること。尚、試験は特に指定のない限り JIS C 60068-1 [環境試験方法 (電気、電子)通則]に規定された試験場所の標準にて実施する。

The performances tested under the conditions and methods given in the table below shall conform to the respective specifications. Unless otherwise specified, carry out the tests according to the standards of a place of test stipulated in IEC 60068-1 "General Rules of Environmental Testing Method (Electric and Electronic)".

#### 5-1 外観 (Appearance)

	·	, I=15.55	条件
No.	項目	規格値	
NO.	Item Description		Check
5-1-1	外観	使用上有害となる様な割れ・変形等が無いこと	
3-1-1	Appearance	Crack, deformation, etc. harmful in use are not allowed	Visual

#### 5-2 機械的性能 (Mechanical properties)

No.	項目 Item	規格値 Description		試験条件及び方法 Check
5-2-1	圧着部引張強度 Tensile strength of crimped section	電線 Wire size AWG#24 AWG#26 AWG#28	強度 N 以上 Minimum strength in N 2 9.4 1 9.6	ターミナルのワイヤバレルと電線 導体を圧着し、治具で固定し電線 の軸方向に引っ張る。 試験速度 2.5 ± 3 mm/min Crimp the terminal's wire barrel and conductor together, fasten the altogether, and pull the wire axially at 25 ± 3 mm/min.
5-2-2	基板保持力 P.C.B. Pull- out force	4.9N以上 4.9Normore		試験速度 25±3mm/min Pull out speed 25±3 mm/min.
5-2-3	基板挿入力 P.C.B. Insertion force	29.4N 以下 29.4 N or less		試験速度 25±3mm/min Inserting speed 25±3 mm/min.

# 仕 様 書 Specifications

5-3 耐久環境性能 (Durability)

5-3 f	,	urability)		
No.	項目 Item		!格値 ription	試験条件及び方法 Check
5-3-1	耐塩水噴霧性	接触抵抗 Contact resistance	20m 以下 20mΩ or less	下記条件に放置。 温度 35±2 塩水濃度 5±1% (重量比) 噴霧時間 48時間 接触抵抗測定は、水洗をし室温で 乾燥後測定。 1~2時間放置後測定
	Salt mist	りを 外観 Appearance	異常なきこと Shall remain normal	Keep the sample under following conditions.  Temperature 35 ± 2°C.  Salt concentration 5 ± 1%wt.  Spray time 48 h.  Then, rinse the sample, and leave it dry at room temperature for 1 to 2 h.
5-3-2	耐硫化水素 ガス性 Hydrogen sulfide	接触抵抗 Contact resistance	20m 以下 20mΩ or less	下記条件に放置。 塩水濃度 3 ± 1 p p m 温度 4 0 ± 2 噴霧時間 2 4 時間 接触抵抗測定は、水洗をし室温で 乾燥後測定。 1 ~ 2 時間放置後測定
		外観 Appearance	異常なきこと Shall remain normal	Keep it in hydrogen sulfide for 24 h. Density $3\pm1$ ppm. Temperature $40\pm2^{\circ}\text{C}$ . Leave the sample for 1 to 2 h before check.
	耐アンモニア性	接触抵抗 Contact resistance	20m 以下 20mΩ or less	下記アンモニア水の入ったデシケータ容器中に放置。 濃度 28% 温度 25±2 湿度 90~95% 放置時間 40分 1~2時間放置後測定。
5-3-3	Ammonia	外観 Appearance	異常なきこと Shall remain normal	Engage the connector, and keep it in desiccator filled with following aqueous ammonia for 40 min. Concentration 28%. Temperature 25 $\pm$ 2°C. Relative humidity 90 to 95%. Leave the sample for 1 to 2 h before check.

# 仕 樣 書 Specifications

5-4 半田付性能 (Soldering characteristics)

No.	項目	規格値	試験条件及び方法
Item		Description	Check
5-4-1	はんだ付性 Solderability	半田面に半田がムラ無く 全体に付くこと 浸漬面積の95%以上 95% or more of dipped solder side shall be coated uniformly with solder	はんだ付部をフラックスに5~10秒浸漬後、下記条件のはんだ槽に浸漬する。はんだ槽温度 $245\pm5$ 浸漬時間 $3\pm0.5$ 秒 Dip the soldering section into flux for 5 to 10 sec, and then into solder tank of $245\pm5$ °C for $3\pm0.5$ sec.

